

【原因、判断要点、发生工序】導線の边缘受到某种物体的冲击，或者接触某种物体压坏导线铜所引起的（搬运工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

An edged article hits or touches a conductor and the conductor copper is damaged causing the defect.
(Material handling in all processes)

1-5-3-2 腐食突起／腐蚀的凸出 / Projected conductor by etching of conductor

【特徴】 導体表面が変色し複数の泡状に膨れている状態の表面腐食突起

【特征】 導線表面変色，有几个地方起泡的表面腐蚀的凸出。

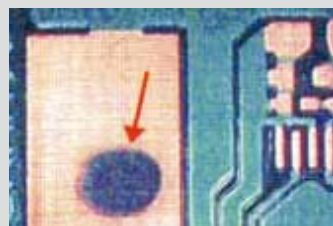
【Characteristics】 Conductive surface is etched, discoloured and swollen to form bubbles.

【原因・判断ポイント・発生工程】 回路形成後の露出導体部に、薬液や水滴等が付着し、その部分が腐食することによって出来たもの

【原因、判断要点、发生工序】 图形转移后的露线部位附着药液或者水滴，该部分被腐蚀而引起的。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Etching of conductor after regular etching of an exposed conductor caused by the wetting of the conductor surface by chemicals or water drops.



【コメント】 黒く腐食して盛り上がっている
顕微鏡倍率×28

【注釋】 腐蚀后变黑并隆起
显微镜倍率 ×28

【Comments】 Etched in black and raised
Magnification: ×28



【コメント】 顕微鏡倍率×

【注釋】 显微镜倍率 ×

【Comments】 Magnification: ×

1-5-3-3 スリバ／镀屑 / Sliver

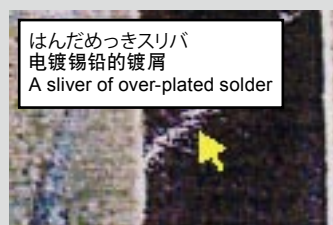
【特徴】 金属 E T レジストのオーバーハング部が針状に剥がれ掛かっている状態の突起

【特征】 在 ET 剂的镀层突沿部位有即将剥落的针形凸出。

【Characteristics】 A needle-shaped overhang of over-plated metal is partially separated.

【原因・判断ポイント・発生工程】

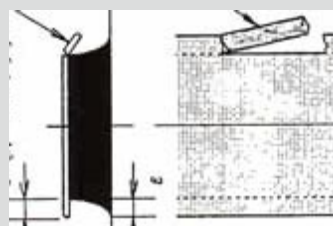
金属 E T レジストのはんだや金めっきのオーバーハング部が針状金属微細片の様相で、導体エッジから離れ掛かって出来たもの。回路導体のオーバーエッチング時に発生し易い（E T 工程、その後の整面工程）



【コメント】 顕微鏡倍率×

【注釋】 显微镜倍率 ×

【Comments】 Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率×

【注釋】 显微镜倍率 ×

【Comments】 Magnification: ×